

ハノーバメッセ2008への出展（4月21日～25日）

4月21日から25日までの5日間、ドイツ、ハノーバー市で開催された欧州最大の産業機器の見本市ハノーバメッセにMEMS協議会会員企業であるオムロン(株)、オリンパス(株)、松下電工(株)、三菱電機(株)、NEDO技術開発機構、及び東京大学のご協力のもと出展し、日本のMEMS関連研究・産業化動向をPRしました。MEMS協議会の海外アフィリエイトであるiVAMがハノーバメッセのサブ展示“Micro Technology Fair”を主催しており、マイクロマシン展と相互協力を行うという目的で2006年より出展しています。

ハノーバメッセは毎年パートナー国を設け、その国にちなんだ開催期間中種々の催し物が行われますが、今年は日本がパートナー国でJETRO、経済産業省が中心となり日本からは例年の2倍以上、100社・機関の展示、及び連日のように関連イベントが催されました。

開会に先立ち4月20日にはハノーバー市内のハノーバーコングレスセントラムにてオープニングレセプションが催され、日本から安倍前首相、ドイツからはメルケル首相が挨拶をされ、日本のアトラクションとして、阿波踊りが紹介されました。

3回目の出展となる今回は、昨年より広い展示ブースを確保し、MEMS協議会が中心となり推進している産業化促進活動を以下の項目に分け展示し、来場者に日本のMEMSをPRしました。

- 1) MEMS協議会の概要紹介
 - ・展示会等によるプロモーション活動
 - ・次期国プロの企画等の政策提言活動
 - ・NEDO/METIプロジェクトへの参画、推進支援、成果のフォロー
 - ・ファンドリーサービスネットワーク活動
 - ・大学、研究所、クラスター、学会等国内関係機関とのネットワーク作り
 - ・国際ナショナルアフィリエイトネットワークの構築
- 2) イベントMicro・Nano2008の紹介
 - ・第19回マイクロマシン/MEMS展
 - ・第14回国際マイクロマシン・ナノテクシンポジウム
- 3) NEDOプロジェクトによる産業技術開発
 - ・産学官連携による産業技術開発支援
 - ・技術戦略マップによるMEMS分野の技術・産業開発シナリオ
- 4) NEDOプロジェクト紹介
 - ・高集積・複合MEMS(ファインMEMS)プロジェクト概要
 - ・選択的ナノ機械構造体形成技術開発：東京大学
 - ・開発中のデバイス断面構造モデル：デモ
- 5) MEMSパッケージング技術：松下電工(株)
 - ・低熱応力ウェハーレベルパッケージング
- ・多層セラミックスMIDパッケージング
- ・MIPTECの紹介ビデオ
- 6) MEMSファンドリー：オリンパス(株)
 - ・オリンパスファンドリーの特長
 - ・装置及び、事例紹介
- 7) 光学向け事業展開：オリンパス(株)
 - ・オプティカルスキャナー
 - ・AFMカンチレバー
 - ・MEMS Flap Actuator
 - ・MEMSスキャナーサンプル展示
- 8) センシング技術：三菱電機(株)
 - ・Pressure Sensor, Accelerometer, Air Flow Sensor
 - ・MEMS Switch、MEMS パッケージ、Switched Capacitor Array
 - ・コアプロセス：バルクマイクロマシニング、サーフェスマイクロマシニング、3Dインテグレーション
- 9) 情報通信向け事業展開：オムロン(株)
 - ・MEMS Microphoneの特長
 - ・アプリケーション
 - ・MEMSマイクデモ

会場には初日にMMC野間口理事長が出展協力いただいた皆様の労をねぎらわれ、主催者でMEMS協議会アフィリエイトのiVAMを代表し、クライケンス氏と懇談されました。また、4月24日にはドイツNRW州の経済大臣がブースを訪問され、日本におけるMEMS産業化促進の状況と、iVAMの活動に対する日本産業界の期待等についてPRしました。



iVAMクライケンス氏と野間口理事長



商談風景



NRW州経済大臣の訪問

また、Microtechnology Fairの会場で催されるForumでは、2日目の4月22日にJapan Dayと称し、MMC青柳専務の開会の挨拶の後、日独両国から、技術開発、事業開発について10件の講演がありました。

来年のメッセは4月20日～24日に開催され、パートナー国は韓国となる予定です。